

证券代码：300757

证券简称：罗博特科

罗博特科智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-02

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
	睿扬投资 张 凯 长江资产 严艺鸣 Hill House 苏雅馨 交银基金 徐嘉辰 泰康资产 刘 宁 Trumed Capital HENRY LIU
时间	2026年2月27日 10:00-11:30
地点	公司 A 栋四楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事长 戴军先生 董事会秘书 李良玉女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司近期概况</p> <p>董事长戴军先生向各位参会方就公司收购的 ficonTEC 公司的发展历史、光电子业务板块的行业发展状况及业务展望等方面进行了总体介绍。</p> <p>二、问题交流</p> <p>1、戴总，能否展望一下 CPO 技术的市场前景？公司对下游需求的爆发节奏有何预判？</p> <p>答复：近期，相信大家已经关注到了一些头部厂商陆续就 CPO 方面发布的一些官方的信息，无论是英伟达和博通还有一些在其他的厂商都在积极推进该技术应用方向进入量产化应用的全新阶段，大家也可以持续关注后续英伟达 GTC 大会</p>

及美国 OFC 方面的发布的官方信息。当然，作为上游设备端，我们根据核心客户给出的具体、明确的需求预测，更清晰的感知到下游市场对 CPO 高速增长的需求，CPO 作为适配高速率、高算力场景的核心技术路径，其产业化正处于全面加速推进的进程中，CPO 产业已步入从技术验证向大规模商业化跨越的关键阶段。ficonTEC 作为全球光电子及半导体自动化封装和测试领域领先的设备制造商，凭借“From Lab to Fab”全周期服务模式深度融入 CPO 产业生态，正迎来空前的行业发展机遇。随着客户的需求预测逐步滚动导入，未来相关订单达到信息披露标准，公司将严格依据法律法规及信息披露制度的要求，及时履行披露义务。

2、请介绍一下 ficonTEC 具体可以提供哪些设备？

答复：ficonTEC 构建了覆盖硅光器件从晶圆测试到封装耦合、模块测试的全流程端到端解决方案，主要产品包括两大产品系列，分别是全自动测试设备系列和全自动组装设备系列。其中全自动测试设备涵盖了从晶圆、晶粒、芯片到后道的模组等各个环节的测试设备；全自动组装设备系列主要包括全自动的光电子器件耦合设备、高精度光纤耦合设备、光芯片贴装设备及芯片堆叠设备等。

ficonTEC 是目前全球少数几家能够为 800G/1.6T 及以上速率的硅光和 CPO，提供从实验室研发到大规模量产所需的全自动封装与测试设备的供应商。

以晶圆测试设备为例，ficonTEC 可以根据客户设计不同，提供两种适用场景下的测试设备，双面晶圆测试设备和单面晶圆测试设备。其中双面晶圆测试设备是全球业界首创的双面测试解决方案，晶圆顶面连接 ATE 电学探针卡，底面进行高精度光学 I/O 六轴有源对准探测，完美适配 CPO 光引擎的“上电下光”3D 堆叠结构。单面光电晶圆测试机则将电学探针接

口和光学六轴对准探测集成在晶圆同一顶侧，大幅简化与现有 ATE 系统的整合。

在晶圆测试设备方面，ficonTEC 还开发了如晶圆 Trimming 和在线清洁除尘的辅助功能。Trimming 功能，可在测试中帮助微调芯片内的光学结构，将性能不合格的芯片修复为合格品，叠加在线清洁除尘的功能将直接帮助客户提升产品良率。

3、如何看待公司的 CPO 设备在下游应用领域的地位？

答复：ficonTEC 是全球光电子及半导体自动化封装测试领域的领先设备供应商，在下游多个核心应用场景中具备突出的竞争优势与较高的市场认可度。公司与英伟达、博通、台积电、英特尔、思科等全球头部科技企业保持长期稳定的合作关系，产品已获得全球头部客户的广泛认可，是唯一一家提供覆盖硅光器件整个制造流程的端到端全自动化解决方案的设备供应商。

甚至在部分特定的应用场景，截至目前，ficonTEC 设备仍处在独供的特殊地位，例如：专为满足 CPU、GPU 和交换设备中垂直集成光子与电子芯片堆栈的测试需求而打造的双面晶圆测试设备，该设备可兼容行业标准半导体自动化测试（ATE）平台，独创性地实现了晶圆正反两面电学与光学测试同步进行，完美适配 TSMC COUPE（紧凑通用光子引擎）等尖端设计方案的测试要求。当前，该双面晶圆测试设备已完成了客户端口的可靠性验证，并已获得量产化订单，随着下游核心客户量产化进程的不断推进，后续需求将进一步快速增长。

4、在目前下游客户给出较好的需求预测情况下，请问公司当前的产能布局能否支撑硅光、CPO、OCS 等核心业务的快速增长？后续在产能扩充方面有何整体规划？

答复：根据未来市场端的快速增长态势及核心客户的需求预测来看，公司确实亟待迅速提升产能匹配的能力。伴随着硅光、CPO 的产业化进程，对 ficonTEC 的设备需求量将不断快速增长，公司将根据需求，在国内外同步提升产能以保障全球客户对交期与服务需求，充分把握行业发展机遇。

目前，公司正在积极拓展上游供应链的相关布局，向相关供应商提出了根据我们的要求相应迅速扩充其产能以匹配我们快速增长的需求。同时，在不断快速提升现有德国、爱沙尼亚、中国生产/组装基地产能的基础上，公司计划将增设新的生产/组装基地作为补充，以进一步提升总体产能。同时，公司还将持续提升全球化服务的能力，以更好地满足全球客户的需求。

5、请问公司 OCS 订单情况及未来需求如何？

答复：在 OCS 技术路线布局方面，公司已与产业链核心参与方建立起深度的战略协同关系。截至目前，ficonTEC 与瑞士某头部客户签订了两条完整的自动化产线设备订单，用于其 OCS 核心模块的生产制造。根据客户端提出的交付计划要求，首条自动化整线设备预计将于今年第一季度完成交付；第二条自动化整线设备预计也将在首条交付完成后尽快完成交付。

基于该客户未来的扩产规划，后续仍存在较多的新增产线需求，公司将积极响应并匹配其产能建设节奏。受限于下游客户的保密协议约束，相关合作的具体细节暂不便对外披露。未来若相关业务进展触及信息披露标准，公司将严格依据法律法规及信息披露制度的要求，及时履行披露义务，敬请广大投资者关注公司后续的官方公告。

6、理解公司在 CPO、OCS 等前沿技术领域已有领先的

布局,在传统可插拔光模块技术领域方面是否有相应的布局?

答复:事实上, ficonTEC 在这些技术方向上是全覆盖的,除了在硅光、CPO、OCS 等技术方向上有着全球领先的技术及市场优势以外,在传统可插拔光模块方面,我们亦有独特的竞争优势。当前,随着 AI 对需求侧爆发式增长的驱动,传统可插拔光模块客户及新玩家都在纷纷加速推进各自的产能扩张计划,技术、产品迭代方向正逐步向更高速率、更高集成度的方向演进,伴随单件价值提升与良率门槛趋严,封装与测试环节的工艺复杂度显著上升。相较于传统依赖人力的制造方式,全自动化制造模式正日益凸显其在价值创造方面的显著优势。同时,结合罗博特科在智能工厂解决方案方面的技术积淀,以及 ficonTEC 在光电子端到端自动化设备领域的核心能力,我们正致力于为光电子行业构建完整的智能工厂解决方案,越来越多的客户在规划新产能时也越来越多认可我们能为其带来的价值赋能,预期该方向也将为公司带来较好的增长。

7、ficonTEC 设备的竞争优势和护城河是什么?

答复:首先, ficonTEC 在自身二十余年发展与经验积累的基础上,通过与国际顶尖研究机构的前瞻性研发协作,奠定了技术领先性的根基。自成立以来,公司深度参与并始终致力于推动光子学领域基础技术的演进与革新,与全球一流科研院所及高等学府建立了长期、稳定且深入的战略合作关系。这些前瞻性合作为 ficonTEC 在光电子与量子技术领域持续保持前沿工艺与技术优势提供了坚实支撑。

其次, ficonTEC 依托运动控制、视觉系统及 PCM 核心控制算法软件三大关键技术支撑,构建了覆盖硅光器件从晶圆测试到封装耦合、模块测试的全流程端到端解决方案,能够适配不同技术路线的自动化量产需求,形成完整的系统化交付能力。

	<p>最后，ficonTEC 贯彻“从原型开发到小批量试产，再扩展至大规模量产”的全周期业务模式。在此过程中，公司紧密协同下游客户需求，持续优化设备功能、精度与效率，积淀了深厚的工艺经验。这些经验与设计知识已系统融入核心控制算法软件（PCM），并通过软件迭代逐步形成涵盖主动校准、全面光学组装与测试等在内的多项核心专有技术，构成公司的核心竞争优势。这一基于长期实践所形成的知识体系，已转化为以算法软件为载体、嵌入产品设计的内生技术能力，难以在短期内复制或超越。同时，公司已将机器学习技术集成于 PCM 软件中，显著加速算法优化与迭代进程，进一步巩固了技术壁垒的可持续性。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>附件清单(如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026 年 3 月 1 日</p>